



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、_____ 殿 に納入する

1.27mm ピッチ メモリ・カード用コネクタについて規定する。

This specification covers the 1.27mm PITCH MEMORY CARD CONNECTOR series.

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製品名称 Product Name	製品型番 Parts Number
ヘッダーアッセンブリー Header Assembly	55358-5021
イジェクト メカニズム Eject Mechanism	55364-0011

図面参照 Refer to the attached drawing.

【3. 定 格 RATINGS】

項 目 Item	規 格 Standard
最大許容電圧 Rated Voltage(MAX.)	100V [AC < 実効値 rms >]
最大許容電流 Rated Current(MAX.)	0.5 A [DC]
使用温度範囲 Ambient Temperature Range.	-20℃ ~ +90℃ *1
保存温度範囲 Storege Temperature Range.	-40℃ ~ +70℃
使用湿度範囲 Ambient Humidity Range.	95%R. H. MAX. *2

*1 通電による温度上昇分も含む。
Including terminal temperature rise.

*2 但し結露しないこと
No Condensation Permitted.

REV	A						
SHT	1~10						
REVISE ON CAD ONLY		TITLE 1.27mm PITCH MEMORY CARD CONN. 製品仕様書					
A	RELEASED JD2000-1268 '00/05/26 YUKOJIMA	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					
REV	DESCRIPTION	WRITTEN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE: YR/MO/DAY		
DESIGN CONTROL	STATUS	<i>Yu.Kojima</i>	<i>M. Sasao</i>	<i>A. Jiro</i>	2000/05/26		
JD					FILE NAME	SHT NO.	
DOCUMENT NO.	PS-55358-009				PS-55358009.S01	1 OF 1	
ES-40000-3999 REV. B		SHEET 1 OF 20		95/MAR/10 EC U5-0926		DOCBORD.DGN LV=55 EN-37C(059) MXJ-55	

【4. 性能パフォーマンス】

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

項目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-1-1 接 触 抵 抗 < 初期値 > Contact Resistance < Initial >	コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、 短絡電流 10mA にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate connectors together and measure contact resistance by dry circuit. 20 mV MAX.,10mA. (JIS C5402 5.4)	40 milliohms MAX.
4-1-2 絶 縁 抵 抗 < 初期値 > Insulation Resistance < Initial >	コネクタを嵌合させ、隣接するピン間及びピン、 アース間に DC500V を印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験方法 302) Mate connectors together and apply 500V DC between adjacent terminals or ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	1000 Megohms MIN.
4-1-3 耐 電 圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するピン間及びピン、 アース間に、AC 500V (実効値) を 1 分間印可する。 「漏洩電流 1mA 以下」 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験方法 301) Mate connectors together and apply 500V AC between adjacent terminals or ground for 1 minute. 「Current leakage 1 mA MAX.」 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異常なきこと No breakdown

4-2. 機能的性能 Mechanical Performance

項目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-2-1 単体挿入・抜去力 Individual Insertion / Extraction Force	コネクタを毎分 25±3mm の速さで 挿入、抜去を行なう。 Insert and extract connectors at the speed of 25±3 mm/minute.	挿入力 Insertion Force 28.8 N MAX. {2.94 kgf MAX.}
4-2-2 総合抜去力 Extraction Force	イジェクトボタンを毎分 25±3mm の速さで押し、カードの抜去を行う。 Push eject button at the speed of 25±3 mm/minute.	抜去力 Extraction Force 4.9 N MIN. {0.5 kgf MIN.}
		抜去力 Extraction Force 28.8 N MAX. {2.94 kgf MAX.}

REVISE ON CAD ONLY

TITLE 1.27mm PITCH MEMORY CARD CONN.

A SEE SHEET 1 OF 10

製品仕様書

REV DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO
MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NO.

FILE NAME SHEET

PS-55358-009

PS-55358009.S02 2 OF 10

ES-40000-3999 REV. B

SHEET 2

DOCBOARD.DGN LV=56

EN-37-IC(059) MXJ-56

EC U5-0926

EN-37-IC(059) MXJ-56



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement
4-2-3 ピン保持力 Male-pin Pull-out Force	毎分 25±3mm の速さでピンを軸方向に押す。 Apply axial compressive force to a pin at a rate of 25±3 mm/minute.	9.8 N MIN. (1.0 kgf MIN.)
4-2-4 ボタン機構 操作部強度 Button Strength	操作部先端に、操作方向と垂直に 7.36 N (0.75 kgf) の静荷重を 5 秒間加える。 Apply 7.36 N (0.75kgf) to button for 15 seconds in direction that makes a right angle with operating direction.	異常なきこと No Damage

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement
4-3-1 温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合せ、最大許容電流を 通電し、コネクタの温度上昇分を測定 する。(UL 498) Mate connectors together, carry rated current load, and measure temperature rise. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise 30 °C MAX.
4-3-2 耐振性 Vibration	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む 互いに垂直な 3 方向に掃引割合 10〜2000〜10Hz / 20分、 全振幅 1.5mm の振動を各 4 時間加える。 (MIL-STD-202 試験方法 204) 但し、ボタンのロックが解除するのは異常 とは見なさない。 Amplitude :15mm P-P Sweep time :10-2000-10Hz in 20 minutes. Duration :4 hours in each X-Y-Z-axes. Electronical :DC 1mA current (MIL-STD-202 Method 204) It is not fail that button is released from latching position.	外観 Appearance 異常なきこと No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 milliohms MAX. 瞬断 Discontinuity 0.1 microsecond MAX.

REVISE ON CAD ONLY

TITLE 1.27mm PITCH MEMORY CARD CONN.

A SEE SHEET 1 OF 10

製品仕様書

REV DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO
MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NO.

PS-55358-009

FILE NAME SHEET

ES-40000-3999 REV. B SHEET 2

2

95/MAR/10

EC U5-0926

DOCBOARD.DGN

LV=56

EN-37-1C(059) MXJ-56

PS-55358009.S03

3 OF 10

EN-37-1C(059) MXJ-56



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement
4-3-3 耐衝撃性 Shock	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 6 方向に 490m/s^2 (50G) の衝撃を各 3 回加える。 (JIS C0041/MIL-STD 試験方法 213) 但し、ボタンのロックが解除するのは異常とは見なさない。 Mate connectors and subject to the following shock conditions. 3 shocks shall be applied along 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA current during the test. (Total of 18 shocks) Peak Value : 490m/s^2 {50G} (JIS C0041/MIL-STD-202 Method 213) It is not fail that button is released from latching position.	外観 Appearance 異常なきこと No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 milliohms MAX. 瞬断 Discontinuity 0.1 microsecond MAX.
4-3-4 耐熱性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、 $85\pm 2^\circ\text{C}$ の雰囲気中 250 時間放置後取り出し、1~2 時間室温に放置する。 (JIS C0021/MIL-STD-202 試験方法 108) Mate connectors and expose to $85\pm 2^\circ\text{C}$ for 250 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C0021/MIL-STD-202 Method 108)	外観 Appearance 異常なきこと No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 milliohms MAX.
4-3-5 耐寒性 Cold Resistance	コネクタを嵌合させ、 $-55\pm 3^\circ\text{C}$ の雰囲気中に 96 時間放置後取り出す。1~2 時間室温に放置する。 (JIS C0020) Mate connectors and expose to $-55\pm 3^\circ\text{C}$ for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C0020)	外観 Appearance 異常なきこと No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 milliohms MAX.

REVISE ON CAD ONLY

TITLE 1.27mm PITCH MEMORY CARD CONN.

A SEE SHEET 1 OF 10

製品仕様書

REV DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NO.

FILE NAME SHEET

PS-55358-009

PS-55358009.S04 4 OF 10

ES-40000-3999 REV. B

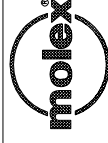
SHEET 2 95/MAR/10 EC U5-0926

DOCBOARD.DGN LV=56

EN-37-1C(059) MXJ-56



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-6	湿度 (定常状態) Humidity (Steady State)	外觀 Appearance	異常なきこと No Damage
		接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohms MAX.
4-3-7	熱衝撃 Thermal Shock	耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3 項を満足のこと Must meet 4-1-3
		絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megohms MIN.
4-3-6	コネクタを嵌合させ、 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 相対湿度 90 ~ 95% の雰囲気中に 96 時間放置後取り出し、1 ~ 2 時間 室温に放置する。 (JIS C0022/MIL-STD-202 試験方法 103)	外觀 Appearance	異常なきこと No Damage
		接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohms MAX.
4-3-7	コネクタを嵌合させ、 $-55\pm 3^{\circ}\text{C}$ に 30 分 $+85\pm 3^{\circ}\text{C}$ に 30 分、これを 1 サイクルとし 5 サイクル繰り返し。但し、温度移行時間 は 3 分以内とする。 試験後 1 ~ 2 時間 室温に放置する。 (MIL-STD-202 試験方法 107)	絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megohms MIN.
		絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megohms MIN.

REVISE ON CAD ONLY

TITLE 1.27mm PITCH MEMORY CARD CONN.

A SEE SHEET 1 OF 10

製品仕様書

REV DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NO.

FILE NAME SHEET

PS-55358-009

PS-55358009.S05 5 OF 10

ES-40000-3999 REV. B

95/MAR/10 EC U5-0926

DOCBOARD.DGN LV=56

SHEET 2

EN-37-IC(059) MXJ-56



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement
4-3-8 塩水噴霧 Salt Spray	<p>コネクタを嵌合させ、35±2℃にて5±1%重量比の塩水を48±4時間噴霧し試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C0023/MIL-STD-202 試験方法101) Mate connectors and expose to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by gentle wash or dipped in running water, after which the specified measurements shall be performed.</p> <p>NaCl solution concentration : 5±1% Spray time : 48±4 hours Ambient temperature : 35±2℃ (JIS C0023/MIL-STD-202 Method 101)</p>	<p>外観 Appearance</p> <p>異常なきこと No Damage</p> <p>接触抵抗 Contact Resistance</p> <p>60 milliohms MAX.</p>
4-3-9 硫化水素ガス H ₂ S Gas	<p>コネクタを嵌合させ、40±2℃、相対湿度約80%、3±10ppmの硫化水素ガス中に96時間放置する。(JEIDA-38) Mate connectors together and expose them to the following H₂S gas atmosphere. Temperature : 40±2℃ Relative Humidity : approx. 80% Gas Density : 3±1 ppm. Duration : 96 hours (JEIDA-38)</p>	<p>外観 Appearance</p> <p>異常なきこと No Damage</p> <p>接触抵抗 Contact Resistance</p> <p>60 milliohms MAX.</p>
4-3-10 耐湿性 Moisture Resistance	<p>コネクタを嵌合させ、第6項に示す条件にて9サイクル行い、10サイクル目は段階6迄の試験を行う。但し、段階7aは初めの9サイクルのうち5サイクルについて行う。試験後、室温に24時間放置する。(MIL-STD-202 試験方法106) Mate connectors and subject to the conditions specified on per.61 for 9 cycles. The test specimens test specimens shall be exposed to STEP 7a during only 5 out of 9 cycles. A 10th cycles consisting of only step 1 through 6 is then performed, after which the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 24 hours. (MIL-STD-202 Method 106)</p>	<p>外観 Appearance</p> <p>異常なきこと No Damage</p> <p>接触抵抗 Contact Resistance</p> <p>60 milliohms MAX.</p> <p>耐電圧 Dielectric Strength</p> <p>4-1-3 項を満足のこと Must meet 4-1-3</p> <p>絶縁抵抗 Insulation Resistance</p> <p>100 Megohms MIN.</p>

REVISE ON CAD ONLY

TITLE 1.27mm PITCH MEMORY CARD CONN.

A SEE SHEET 1 OF 10

製品仕様書

REV DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NO.
PS-55358-009

FILE NAME SHEET
PS-55358009.S06 6 OF 10

ES-40000-3999 REV. B

SHEET 2 95/MAR/10 EC U5-0926

DOCBOARD.DGN LV=56
EN-37-IC(059) MXJ-56



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement
4-3-11	<p>1 時間に 400 ～ 600 回 の速さで挿入・抜去を 10000 回 繰り返し行う。 Repeat insertion and extraction up to 10000 cycle at the rate of 400-600 cycle per hour.</p>	<p>外 観 Appearance</p> <p>異常なきこと No Damage</p>
4-3-12	<p>下記順序にて試験を行なう。 ① 挿入・抜去 : 1000 回 ② 耐湿性試験 ③ 挿入・抜去 : 1000 回 ④ 耐湿性試験 ⑤ 挿入・抜去 : 3000 回 ⑥ 耐湿性試験 ⑦ 硫化水素ガス試験 挿抜速度 : 400 ～ 600 回 / 1H 耐湿性試験 : 4-3-10 項 (但し 1 サイクル 24 時間) 硫化水素ガス試験 : 4-3-9 項 Test Sequence ① 1000 cycle Insertion/Extraction ② Moisture Resistance Test 14-3-10, 1 cycle 24 hours ③ 1000 cycle Insertion/Extraction ④ Moisture Resistance Test 14-3-10, 1 cycle 24 hours ⑤ 3000 cycle Insertion/Extraction ⑥ Moisture Resistance Test 14-3-10, 1 cycle 24 hours ⑦ H₂S Gas Test (4-3-9) Insertion/Extraction Test Cond. Repeat insertion and extraction at the rate of 400-600 cycles per hour.</p>	<p>外 観 Appearance</p> <p>異常なきこと No Damage</p>
4-3-13	<p>端子先端より 0.5mm の位置まで 230 ± 5℃ の半田に 3 ± 0.5 秒 浸す。 Dip solder tails into the molten solder < held at 230 ± 5℃ > up to 0.5 mm from the bottom of the housing for 3 ± 5 second.</p>	<p>濡 れ 性 Solder Wetting</p> <p>浸清面積の 95% 以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes</p>

REVISE ON CAD ONLY

TITLE 1.27mm PITCH MEMORY CARD CONN.

A SEE SHEET 1 OF 10

製品仕様書

REV DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NO.

PS-55358-009

FILE NAME SHEET

ES-40000-3999 REV. B

SHEET 2

95/MAR/10

EC U5-0926

DOCBOARD.DGN

LV=56

EN-37-IC(059) MXJ-56

EN-37-IC(059) MXJ-56

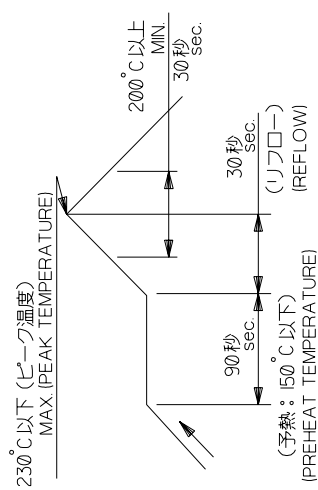


PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item	条件 Test Condition	規格 Requirement
<p>4-3-14</p> <p>ヘッドアッセンブリ 半田耐熱性 Header Assembly Resistance to Soldering Heat</p>	<p>赤外線リフロー条件 INFRARED REFLOW CONDITIONS</p>  <p>230°C以下 (ピーク温度) MAX. (PEAK TEMPERATURE)</p> <p>90秒 Sec.</p> <p>30秒 Sec.</p> <p>200°C以上 MIN. 30秒 Sec.</p> <p>(予熱: 150°C以下) (PREHEAT TEMPERATURE)</p> <p>(リフロー) (REFLOW)</p> <p>温度条件グラフ (基板表面温度) TEMPERATURE CONDITION GRAPH (TEMPERATURE ON BOARD PATTERN SIDE)</p>	<p>外観 Appearance</p> <p>端子ガタ、割れ等 異常なきこと No Damage</p>

{ } : 参考規格

Reference Unit

REVISE ON CAD ONLY

A SEE SHEET 1 OF 10

REV DESCRIPTION

DOCUMENT NO. PS-55358-009

ES-40000-3999 REV. B SHEET 2

95/MAR/10 EC U5-0926

DOCBOARD.DGN LV=56
EN-37-IC(059) MXJ-56

TITLE 1.27mm PITCH MEMORY CARD CONN.

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

FILE NAME SHEET

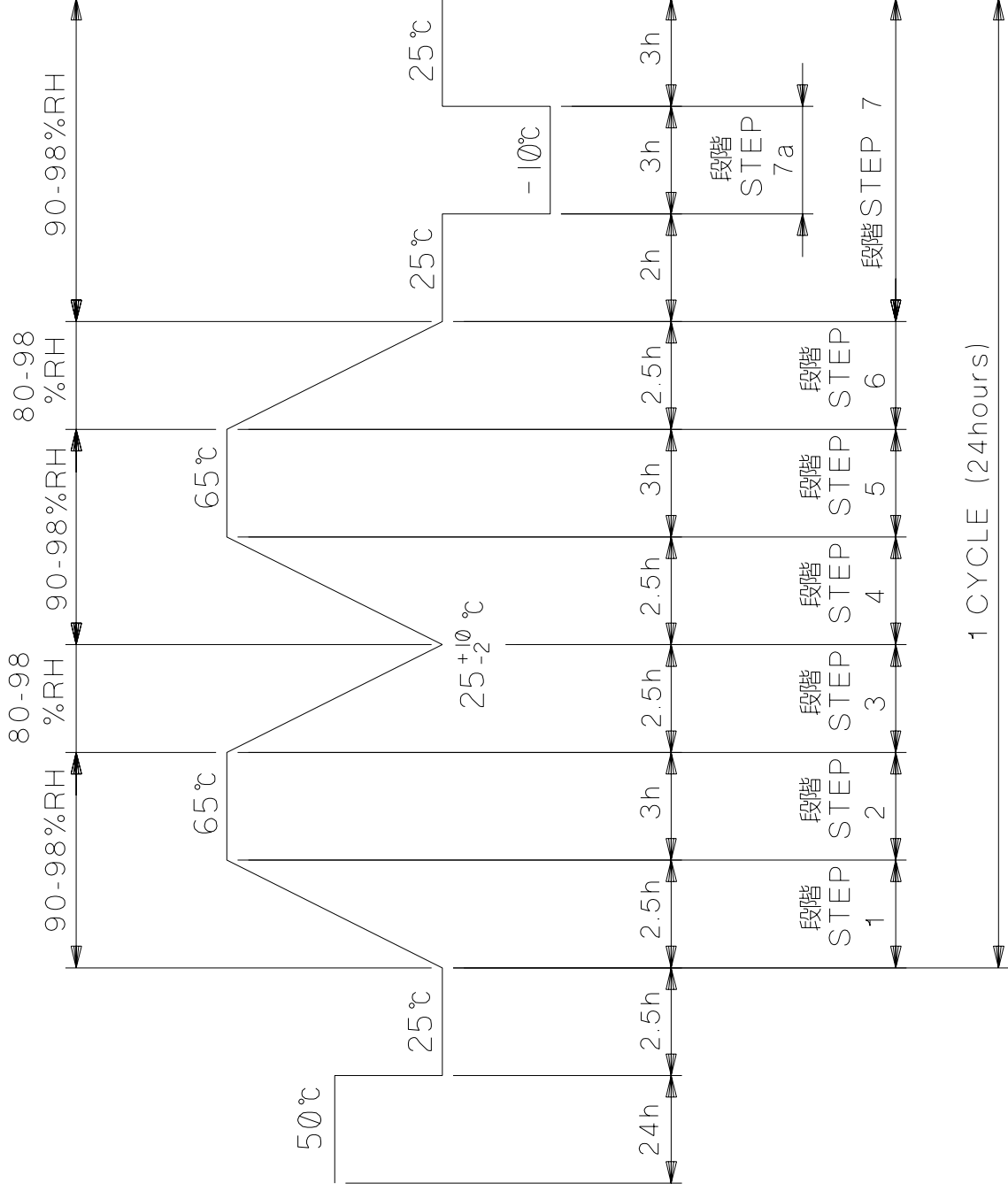
PS-55358009.S08 8 OF 10

【5. 外觀形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照 Refer to the drawing.

【6. 耐湿性試験条件 Moisture resistance conditions】

MIL-STD-202 試験法 106
MIL-STD-202 Method 106



REVISE ON CAD ONLY

TITLE 1.27mm PITCH MEMORY CARD CONN.
製品仕様書

A SEE SHEET 1 OF 10

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV DESCRIPTION

DOCUMENT NO.

FILE NAME SHEET

PS-55358-009

PS-55358009.S09 9 OF 10

ES-40000-3999 REV. B SHEET 2

95/MAR/10 EC U5-0926

DOCBORD.DGN LV=56

EN-37-IC(059) MXJ-56

DWG. NO. SD-55364-002

F

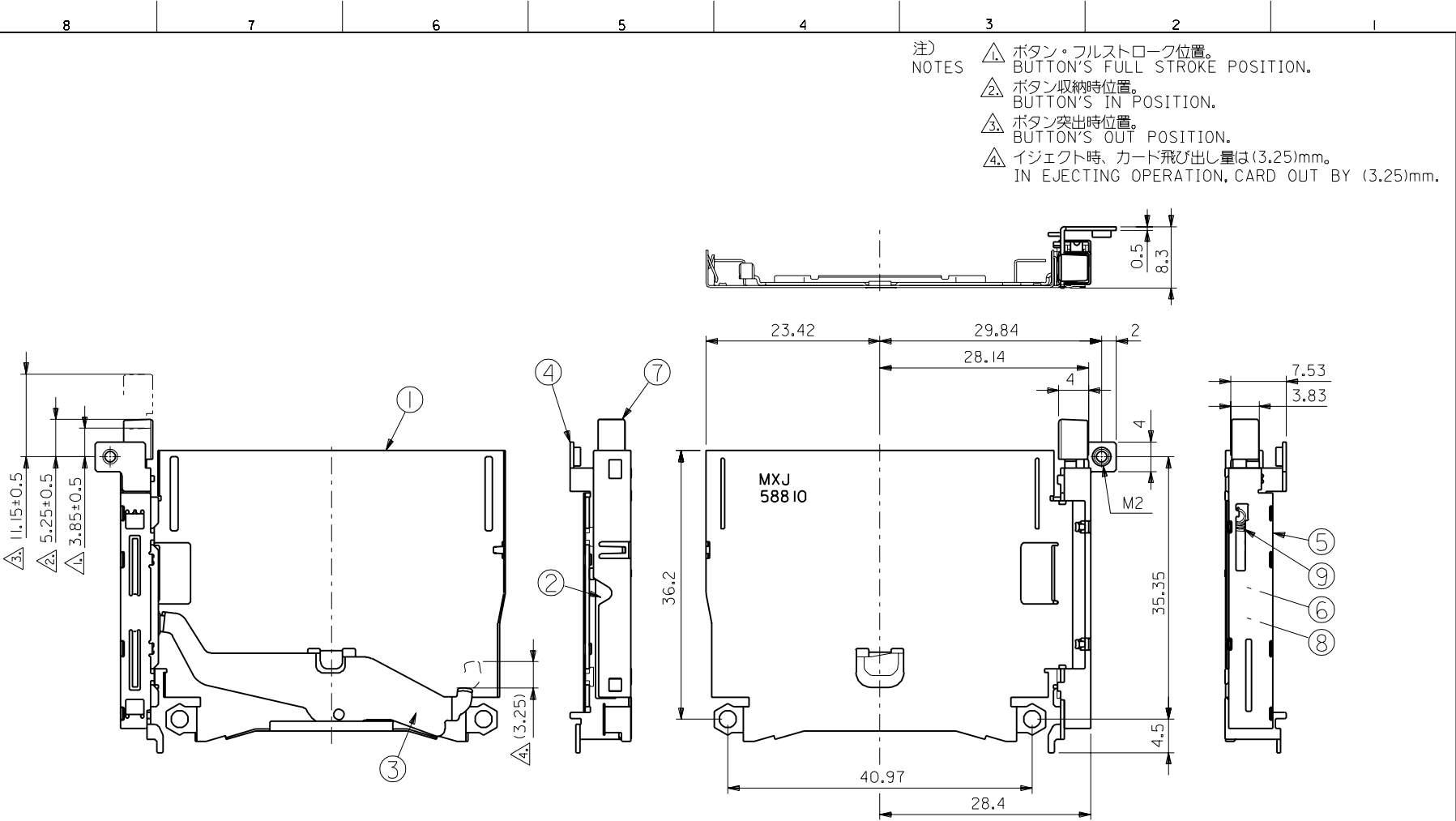
D

V

C

B

DO NOT SCALE DRAWING



注) NOTES

- △ ボタン・フルストローク位置。
BUTTON'S FULL STROKE POSITION.
- △ ボタン収納時位置。
BUTTON'S IN POSITION.
- △ ボタン突出時位置。
BUTTON'S OUT POSITION.
- △ イジェクト時、カード飛び出し量は(3.25)mm。
IN EJECTING OPERATION, CARD OUT BY (3.25)mm.

EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

RELEASED
EC NO. JD90381
DRWN: THIRATA '98/09/09
CHK: MSASAO '98/09/08
APPR: HIKESUGI '98/09/09

MATERIAL 材料	SEE NOTES
FINISH 仕上げ	SEE NOTES
WIRE RANGE 適用線径範囲	— # —
INS. RANGE 被覆外径	— # —

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	
10 UNDER 未満	+0.2
10 OVER 以上 30 UNDER 未満	+0.25
30 OVER 以上	+0.3
ANGLE 角度	+3°

SCALE 2 - 1	DESIGN UNITS <input checked="" type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> INCH
DRAWN BY & DATE T. Kinata '98/09/09	TITLE: CF CARD CONN. EJECT MECHANISM EJECT ASS'Y
CHECKED BY & DATE H. Saeb '98/09/09	APPROVED BY & DATE [Signature] '98/09/09
CAD FILENAME 55364002.S01	MATERIAL NO. 55364-0011

DIMENSIONS: <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> INCH <input checked="" type="checkbox"/> mm ONLY		SHT REV
THIRD ANGLE PROJECTION		REVISE ON CAD ONLY
MOLEX INCORPORATED		
DRAWING NO. SD-55364-002	SHEET NO. 1 OF 2	SIZE B

EN-02J(097) MXJ-54

F

E

D

C

B

A

55364002.S01

DWG. NO. SD-55364-003

F

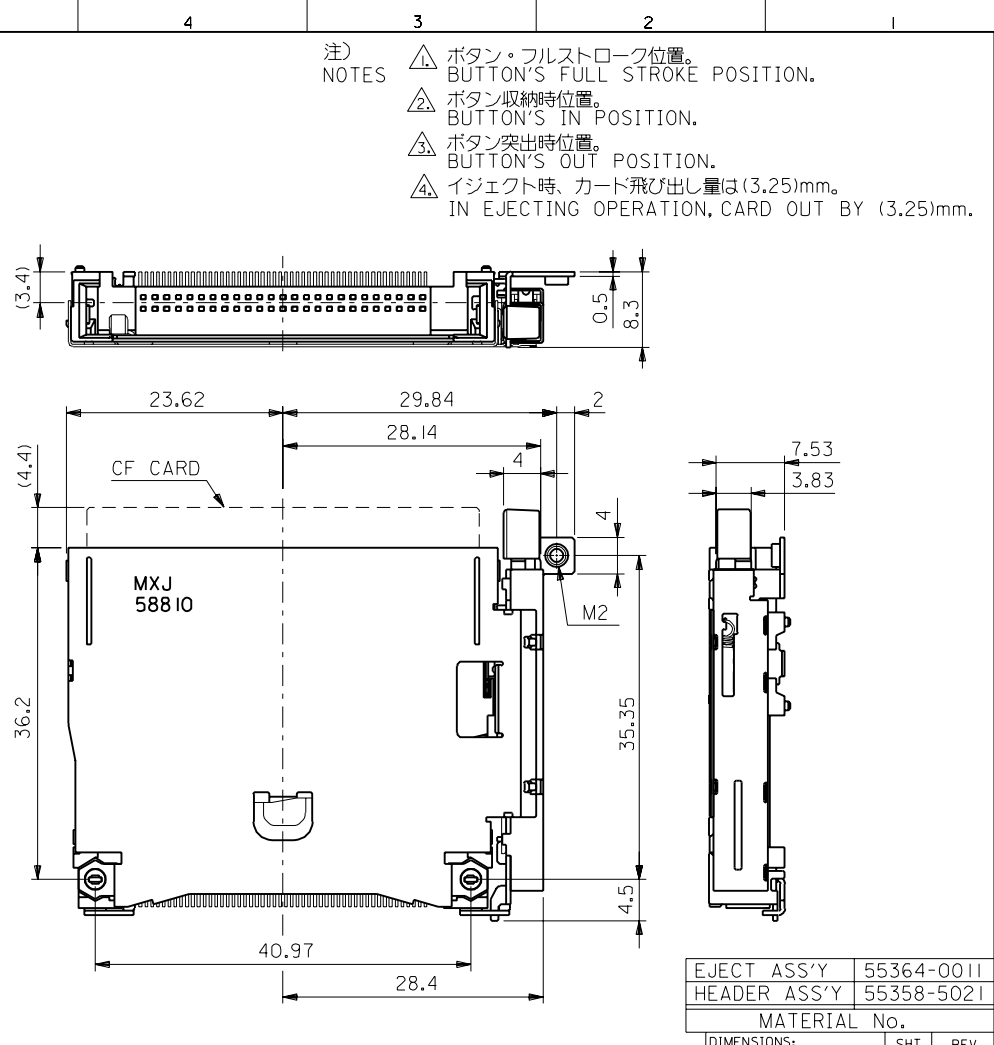
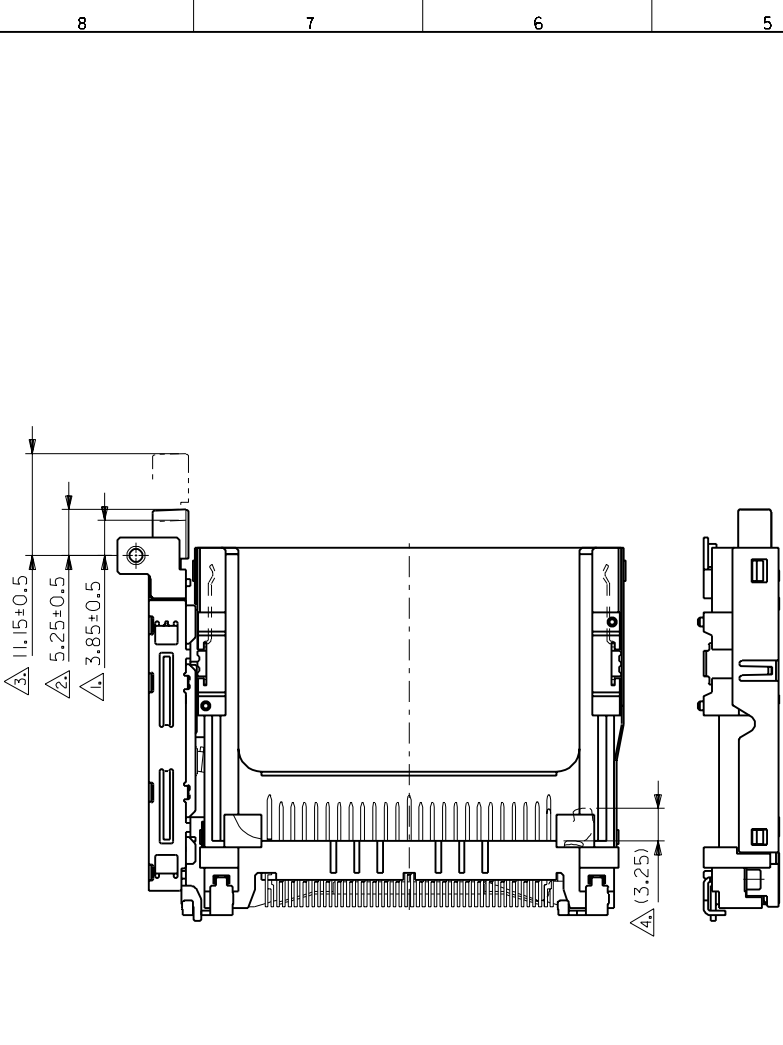
D

V

C

B

DO NOT SCALE DRAWING



- 注) NOTES
- △ ボタン・フルストローク位置。
BUTTON'S FULL STROKE POSITION.
 - △ ボタン収納時位置。
BUTTON'S IN POSITION.
 - △ ボタン突出時位置。
BUTTON'S OUT POSITION.
 - △ イジェクト時、カード飛び出し量は(3.25)mm。
IN EJECTING OPERATION, CARD OUT BY (3.25)mm.

EJECT ASS'Y	55364-0011
HEADER ASS'Y	55358-5021
MATERIAL No.	

DIMENSIONS:		SHT	REV
<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> INCH	<input checked="" type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> ONLY
		REVISE ON CAD ONLY	

TITLE: CF CARD CONN. EJECT MECHANISM (TYPE I/II, NORMAL)

APPROVED BY & DATE: *H. Saito* '98/09/08

CAD FILENAME: 55364003.SOI

MATERIAL NO. SEE TABLE

DRAWING NO. SD-55364-003

SHEET NO. 1 OF 3

SIZE B

EC NO.	REVISED
DRWN: THIRATA '99/07/31	JD2000-1126
CHK: MSASAO '99/07/31	DRWN: THIRATA '99/07/31
APPR: HIKESUGI '99/07/31	CHK: MSASAO '99/07/31
EC NO.	REVISED
DRWN: THIRATA '99/07/31	JDO0137
CHK: MSASAO '99/07/31	DRWN: THIRATA '99/07/31
APPR: HIKESUGI '99/07/31	CHK: MSASAO '99/07/31
EC NO.	RELEASED
DRWN: THIRATA '98/09/08	JD90360
CHK: MSASAO '98/09/08	DRWN: THIRATA '98/09/08
APPR: HIKESUGI '98/09/08	CHK: MSASAO '98/09/08

MATERIAL	材料	#
FINISH	仕上げ	#
WIRE RANGE	適用電線範囲	#
INS. RANGE	被覆外径	#

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	
10 UNDER 未満	+0.2
10 OVER 以上 30 UNDER 未満	+0.25
30 OVER 以上	+0.3
ANGLE 角度	+3°

SCALE	2 - 1
DESIGN UNITS	<input checked="" type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> INCH
THIRD ANGLE PROJECTION	<input checked="" type="checkbox"/>
DRAWN BY & DATE	<i>T. Kinata</i> '98/09/08
CHECKED BY & DATE	<i>H. Saito</i> '98/09/08
APPROVED BY & DATE	<i>H. Saito</i> '98/09/08

MOLEX INCORPORATED	
MATERIAL NO.	SEE TABLE
DRAWING NO.	SD-55364-003
SHEET NO.	1 OF 3
SIZE	B

EN-02J(O97) MXJ-54

F

E

D

C

B

A

55364003.SOI

DWG. NO. SD-55364-003

8

7

6

5

4

3

2

1

F

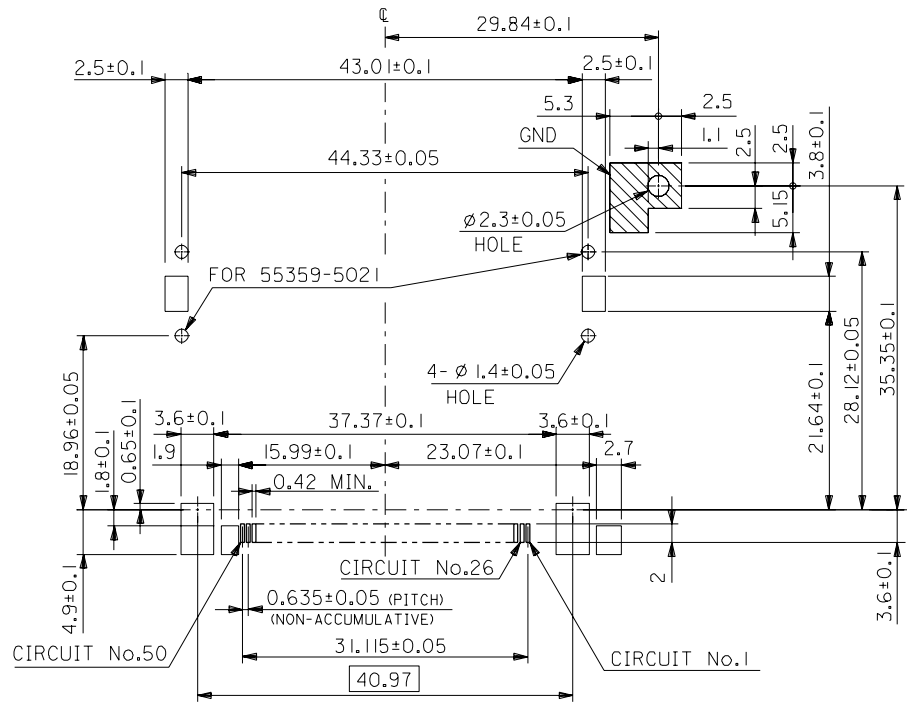
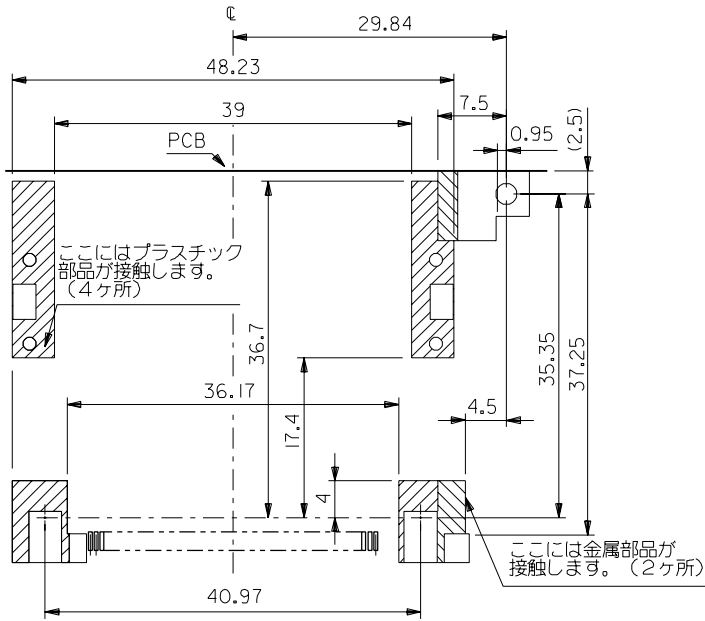
E

D

C

B

A



基板推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

DO NOT SCALE DRAWING

EC NO. DRAWN: CHK: APPR:	EC NO. DRAWN: CHK: APPR:	EC NO. DRAWN: CHK: APPR:	EC NO. DRAWN: CHK: APPR:	EC NO. DRAWN: CHK: APPR:	EC NO. DRAWN: CHK: APPR:
		B	A	0	

DESCRIPTION	REV
MATERIAL 材料	—
FINISH 仕上げ	—
WIRE RANGE 適用導線範囲	—
INS. RANGE 被覆外径	—

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	SCALE	DESIGN UNITS
10 UNDER 未満	2 - 1	☑ mm □ INCH
10 OVER 以上	+0.2	
30 UNDER 未満	+0.25	
30 OVER 以上	+0.3	
ANGLE 角度	+3°	

DRAWN BY & DATE	CHECKED BY & DATE	APPROVED BY & DATE
J. Kinata '98/09/08	H. Saeb '98/09/08	Y. Hongo '98/09/08
CAD FILENAME	MATERIAL NO.	DRAWING NO.
55364003.S02	—	SD-55364-003

DIMENSIONS:	SHT	REV
☐ mm □ INCH ☑ mm ONLY		
THIRD ANGLE PROJECTION	REVISE ON CAD ONLY	
TITLE:	CF CARD CONN. EJECT MECHANISM (TYPE I/II, NORMAL)	
MOLEX INCORPORATED		
SHEET NO.	2	
SIZE	B	

EN-02J(097) MXJ-54

55364003.S02

